



ที่ 51/2569

ข้าราชสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

การประชุมวิชาการนานาชาติไทยและญี่ปุ่นด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ BMEiCON 2026
เตรียมจัดขึ้นที่ฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย Fukuoka Institute of Technology (FIT) นำโดยนาย Tadahiko OHTANI ประธานบอร์ดบริหาร FIT เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ซึ่ง FIT มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ซึ่งมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากกว่า 18 ปี ทั้งด้านการพัฒนางานด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยที่มีศักยภาพมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ FIT รวมประมาณ 70 คน

ในโอกาสนี้ ประธานบอร์ดบริหาร FIT ได้แจ้งว่า ในวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2569 FIT จะร่วมกับสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai Biomedical Engineering Association - ThaiBME) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 18 (18th Biomedical Engineering International Conference - BMEiCON2026) และงานแสดงนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2026 (Biomedical Engineering International Innovation Fair 2026) ณ มหาวิทยาลัย FIT เมืองฟูกูโอกะ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสาขาดังกล่าว โดยจะมีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และนานาชาติ กว่า 500 คน พร้อมกันนี้ ได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ <https://www.bmeicon.org/bmeicon2026/>

7 สิงหาคม 2569





International Steering Committee

Puttisak Puttawibul, Thailand
 Chuchart Pintavirooj, Thailand
 Somkiat Wattanasirichaigoon, Thailand
 Wibool Piyawattanametha, Thailand
 Kosin Chanongthai, Thailand
 Kazuhiko Hamamoto, Japan
 Shinichiro Kanoh, Japan
 Kohji Masuda, Japan
 Keiji Iramina, Japan
 Manfred Glesner, Germany
 Michael Khoo, USA
 Sunu Wibirama, Indonesia
 Viet Dung Nguyen, Vietnam

Organizing Committee

Honorary Chair

Tadahiko Otani,
Chairman
 Fukuoka Institute of Technology

General Chair

Tadayuki Akagi,
 Fukuoka Institute of Technology

General Co-Chair

Chuchart Pintavirooj,
 King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang

Technical Program Chair

Supan Tungjitsukulmun,
 King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang
 Chuchart Pintavirooj,
 King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang
 Supaporn Kiattisin,
 Mahidol University
 Chanchai Thaijiam,
 Srinakharin Tharaviroj University

Publications Chair

Adisorn Leelasantitham,
 Mahidol University

Publicity Chair

Keiko Yoshii,
 Fukuoka Institute of Technology

Finance Chair

Sarinporn Visitsattapongse,
 King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang

Local Arrangement Chair

Xiao Wu,
 Fukuoka Institute of Technology

General Secretary

Satoshi Makita,
 Fukuoka Institute of Technology

The 18th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2026) is intended to provide an international forum where researchers, practitioners, and professionals interested in the advances in, and applications of, biomedical engineering can exchange the latest research, results, and ideas in these areas through presentation and discussion. All accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Explore subject to meeting IEEE Xplore's scope and quality requirement the IEEE logo. The BMEiCON2026 will be held in Fukuoka, Japan on October 10–13, 2026. Fukuoka, the largest city on Japan's Kyushu Island, is a vibrant blend of modern life and rich tradition. Known for its friendly atmosphere, beautiful parks, and coastal scenery, it serves as both a cultural and economic hub of southern Japan. The city is famous for its delicious Hakata ramen, lively street food stalls called yatai, and dynamic festivals like the Hakata Gion Yamakasa. With its mix of bustling shopping districts, historic temples, and easy access to beaches and mountains, Fukuoka offers a perfect balance between urban energy and natural charm.

The organizing committee is pleased to invite all researchers, engineers, physicians, scientists, technicians, and technologists to attend and help shaping the future of biomedical engineering. The topics for regular sessions include, but are not limited to, the followings:

- | | |
|--|--|
| ▶ Biomedical signal processing | ▶ Human machine/computer interface |
| ▶ Biomedical imaging and image processing | ▶ Medical device design |
| ▶ Bioinstrumentation | ▶ Neural and rehabilitation engineering |
| ▶ Bio-robotics and biomechanics | ▶ Technology commercialization, industry, education, and society |
| ▶ Biosensors and biomaterials | ▶ Telemedicine |
| ▶ Cardiovascular and respiratory systems engineering | ▶ Therapeutic and diagnostics systems |
| ▶ Cellular and tissue engineering | ▶ Recent advancements in biomedical engineering |
| ▶ Healthcare information systems | |

Submission of Papers

Prospective authors are invited to submit full-length papers including figures, tables, and references via our website at www.bmeicon.org/bmeicon2026. All papers will be peer reviewed and handled electronically. All papers submitted must be previously unpublished and may not be considered for publication elsewhere at any time during the review period. Any accepted paper included in the final program is expected to have at least one author or qualified proxy attend and present the paper at the conference. For additional information and submission guidelines, please visit our website at www.bmeicon.org/bmeicon2026.

Important Dates

- ▶ Regular paper submission deadline: June 30, 2026
- ▶ Notification of regular paper acceptance: August 1, 2026
- ▶ Camera-ready submission: September 10, 2026
- ▶ Early-bird registration: September 10, 2026
- ▶ Late registration: After October 10, 2026
- ▶ Conference date: October 10-13, 2026

Contacts

- ▶ Chuchart Pintavirooj, KMITL, Thailand
 E-mail: chuchart.pi@kmitl.ac.th,
 Akagi Tadayuki, FIT japan
 Email: t-akagi@fit.ac.jp

Organized by



Supported by

Technical Sponsors

